

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-062

上海合晶硅材料股份有限公司

优质外延片研发及产业化募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“优质外延片研发及产业化项目”。
- 上述项目实施主体为公司全资子公司上海晶盟硅材料有限公司，已满足结项条件且募集资金已使用完毕，结项后无节余资金。
- 审议程序：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，本事项无需提交董事会审议，无需保荐机构发表明确意见。

一、募集资金基本情况

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金总额	150,022.88万元
募集资金净额	139,017.50万元
募集资金到账时间	2024年2月5日

二、本次募投项目结项情况

截至2026年10月，公司2024年首次公开发行股份募投项目“优质外延片研发及产业化项目”已满足结项条件且募集资金已使用完毕，结项后无节余资金。具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	累计投入进度
----	--------	-----------	------------	--------

1	优质外延片研发及产业化项目	18,856.26	18,968.51	100.60%
---	---------------	-----------	-----------	---------

公司“优质外延片研发及产业化项目”募集资金已全部按承诺投入相关项目，专户中的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕，公司决定将该项目予以结项。公司已对相关募集资金专户予以注销，销户完成后公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

三、本次结项的相关程序

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，“优质外延片研发及产业化项目”资金全部使用完毕，无节余资金，无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年10月31日